**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 03/2023**

Warszawa, ..........2023r.

*Miejscowość, data oferty*

**ZAMAWIAJĄCY:**

**ChipCraft Sp. z o.o.**

ul. Bohdana Dobrzańskiego 3 lok. BS073

20-262 Lublin

NIP 9462659910

REGON 364311086

**FORMULARZ OFERTOWY**

**W imieniu oferenta**

**........................................................................................................................**

**........................................................................................................................**

*(pełna nazwa Oferenta, adres siedziby Oferenta, NIP, REGON, dane teleadresowe / ew. czytelna pieczęć, e-mail i nr telefonu osoby do kontaktu)*

**w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 03/2023**

na produkcję obwodu drukowanego (PCB) wraz z zakupem i montażem wybranych elementów elektronicznych, niezbędnych do realizacji projektu pod nazwą: "**Mikrokontroler nawigacyjny do centymetrowej nawigacji satelitarnej ze sprzętowym uwierzytelnianiem pozycji dla urządzeń autonomicznych**", który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

**oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego na poniższych warunkach:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Oferta** | |
| **Kwota** | **Waluta** |
| ***1*** | ***Cena całkowita netto***  ***w tym:***  ***etap 1:***  ***etap 2:*** | **....**  **....**  **....** | **....**  **....**  **....** |
| ***2*** | ***Cena całkowita brutto*** | **....** | **....** |
| ***3*** | ***Termin dostawy etapu 1 zamówienia od dnia zlecenia*** | **....... [tygodni]** | |
| ***4*** | ***Termin dostawy etapu 2 zamówienia od daty zlecenia*** | **....... [tygodni]** | |

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO OBWODU DRUKOWANEGO PCB WEDŁUG DOKUMENTACJI DOSTARCZONEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA):**

1. **Obwód drukowany (PCB) według dokumentacji dostarczonej przez Zmawiającego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr techniczny** | **Wymagany przez Zamawiającego** | **Oferowany przez Wykonawcę** |
|  | Liczba pojedynczych sztuk | 1. Etap nr 1 min 5 szt.  2. Etap nr 2 min 50 szt. |  |
|  | Wymiary pojedynczej sztuki | 98,512 mm x 77,216 mm |  |
|  | Liczba warstw sygnałowych | 4 |  |
|  | Typ laminatu | 1. 18 µm – Cu 2. 376,8 µm – 2x7628 3. 35 µm – Cu 4. 713 µm – rdzeń 5. 35 µm – Cu 6. 376,8 µm – 2x7628 7. 18 µm – Cu |  |
|  | Grubość miedzi | 18/35 µm |  |
|  | Minimalna średnica otworów | 0,2 mm |  |
|  | Minimalna szerokość ścieżki | 5 mils |  |
|  | Minimalny odstęp między ścieżkami | 6 mils |  |
|  | Pokrycie | Złocenie |  |
|  | Test elektryczny | Wymagany |  |
|  | Maska antylutownicza | czarny (preferowany), dwie strony |  |
|  | Opisy | biały (preferowany), jedna strona |  |

1. **Zakup i montaż elementów elektronicznych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Designator** | **Value** | **Footprint** | **Quantity** |
| 1. | C1, C9, C12, C13, C15, C18, C26, C31, C32, C66, C67 | 1uF/10V | C0402(1005) | 11 |
| 2. | C2, C3, C4, C5, C11, C14, C19, C36, C41, C69 | 10uF/10V | C0603(1608) | 10 |
| 3. | C6, C7, C8, C34, C37, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C51, C53, C55, C56, C57, C58, C59, C60, C61, C62, C75 | 100nF/16V | C0402(1005) | 24 |
| 4. | C16, C24 | 22pF/50V | C0402(1005) | 2 |
| 5. | C17, C22, C28, C29, C30, C65 | 22uF/6.3V | C0805(2012) | 6 |
| 6. | C20 | 10nF/16V | C0402(1005) | 1 |
| 7. | C21, C33, C38 | 1nF/16V | C0402(1005) | 3 |
| 8. | C23, C50, C52, C54, C63, C68, C70 | 4.7uF/6.3V | C0402(1005) | 7 |
| 9. | C35 | 220uF/10V | CE-D | 1 |
| 10. | C39, C40 | 27pF/50V | C0402(1005) | 2 |
| 11. | C71 | 33pF/50V | C0402(1005) | 1 |
| 12. | C72, C73 | 100pF/50V | C0402(1005) | 2 |
| 13. | D1 | BAT54CLT1G | SOT-23A | 1 |
| 14. | D2, D5 | KPT-2012EC | 0805LR | 2 |
| 15. | D3, D4, D6 | MBR130LSFT1G | D-SOD123 | 3 |
| 16. | DIP1 | GDH02S04 | DIP\_2P | 1 |
| 17. | J1, J2, J6 | ZL202-20G | HDR2X10 | 3 |
| 18. | J3 | FC68145S | DC\_SOCKETS | 1 |
| 19. | J4 | 221610-0001 | USB 2.0 typC MOLEX- 221610-0001 | 1 |
| 20. | J5 | MP000362 + LIR2032 | CR2032\_BATTERY | 1 |
| 21. | J7 | ZL202-08G | gold\_pin\_2x4 | 1 |
| 22. | J8 | ZL201-02G | JD2 | 1 |
| 23. | L1, L2, L4, L5, L6 | 33nH/100mA | L0402(1005) | 5 |
| 24. | L3 | 100nH/100mA | L0402(1005) | 1 |
| 25. | Q2, Q4 | BSS138PW | SOT323 | 2 |
| 26. | Q3 | 12.00M-SMDXT324 | XTAL 3.2 x 2.5 mm | 1 |
| 27. | R1, R7, R32, R37, R43 | 1k | R0402(1005) | 5 |
| 28. | R2 | 1.6k | R0402(1005) | 1 |
| 29. | R3, R4, R5, R6, R8, R9, R10, R14, R16, R20, R22, R24, R27, R28, R30, R36, R42 | 10k | R0402(1005) | 17 |
| 30. | R11, R13, R19, R21, R23, R33 | 100R | R0402(1005) | 6 |
| 31. | R12, R15, R17, R34 | 0R | R0402(1005) | 4 |
| 32. | R25 | 154k | R0402(1005) | 1 |
| 33. | R26 | 22k | R0402(1005) | 1 |
| 34. | R29 | 4.7k | R0402(1005) | 1 |
| 35. | R31 | 12k | R0402(1005) | 1 |
| 36. | R40 | 4.02k | R0402(1005) | 1 |
| 37. | R41 | 10R | R0402(1005) | 1 |
| 38. | R44, R45 | 5.1k | R0402(1005) | 2 |
| 39. | S1, S2, S3, S4, S5 | KMR243GLFG | KMR243GLFG-Switch | 5 |
| 40. | SHLD1 | 36103305 + 36003300 | 36103305 | 1 |
| 41. | U11) | CCNV2\_A1 | QFN88-0,4(10X10) - PODSTAWKA 2 PASTA | 1 |
| 42. | U22) | S71KS512SC0 | FBGA24-S71KS512SC0 | 1 |
| 43. | U3 | TG2016SMN 16.3680M-ECGNNM3 | TG2016SMn | 1 |
| 44. | U4 | MCP1726-ADJE/SN | SO-8 | 1 |
| 45. | U5 | FT4232HL | QFP64-0,5(10x10) | 1 |
| 46. | U6, U7, U8, U9 | SN74AVC4T774PWR | TSSOP16 | 4 |
| 47. | U10 | PMA2-33LN+ | MC1631 | 1 |
| 48. | U11 | ECS-327TXO-33\_TR | ECS-327TXO-33-TR | 1 |
| 49. | U12 | B8813 | FILTR-SAW-L1 1,1x0,90,45mm | 1 |
| 50. | U14 | TLV73311PQDBVRQ1 | SOT23-5 | 1 |
| 51. | X1 | 142-0701-801 | SMA\_gniazdo\_waskie | 1 |

1. Dostarcza zamawiający, niemontowany dla pierwszych 5 sztuk
2. Montowany tylko dla pierwszych 5 sztuk

* UWAGA: w tabeli powyżej liczba sztuk elementów elektronicznych została podana tylko dla JEDNEJ SZTUKI obwodu drukowanego (PCB).
* Obwód drukowany w etapie 2 może się nieznaczne różnić od obwodu w etapie 1. Po przeprowadzeniu testów pierwszej partii 5 sztuk urządzeń prototypowych może zaistnieć konieczność wprowadzenia korekt do projektu. Spodziewane różnice obejmują drobne zmiany prowadzenia ścieżek na PCB. Przewiduje się także możliwość modyfikacji BOM w zakresie dodania/odjęcia pojedynczych elementów RC. **Zamawiający zakłada, że oferta uwzględnia drobne zmiany komponentów bez wzrostu ceny ofertowej o ile różnice pozostaną na poziomie ±10% ceny jednostkowej zmienianych komponentów** (o ile dotyczy).
* Zamawiający akceptuje bezpośrednie zamienniki elementów o takich samych parametrach, wymiarach obudowy oraz footprint’cie.
* Tolerancja rezystorów min. 1%.
* Moc elementów standardowa dla danej obudowy.

**Oczekiwany czas dostawy etap 1 (liczony od podpisania umowy):** nie dłuższy niż 6 tygodni, od przekazania Wykonawcy zamówienia.

**Oczekiwany czas dostawy etap 2 (liczony od daty zlecenia realizacji zamówienia):** nie dłuższy niż 6 tygodni od daty zlecenia realizacji zamówienia. Przy czym w drugim etapie zlecenie realizacji zamówienia nastąpi najpóźniej w dwa miesiące od dostarczenia przedmiotu zamówienia z etapu pierwszego po przeprowadzeniu przez Zmawiającego testów przedmiotu zamówienia dostarczonego w ramach pierwszego etapu.

UWAGI:

1. W przypadku zastosowania w zapytaniu ofertowym nazw własnych / marek referencyjnych, należy rozumieć, że zamówienie dotyczy produktu lub składowej produktu nie gorszego niż wskazana nazwa/marka.

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Treść oświadczeń** |
| I | Oświadczam, iż podmiot gospodarczy, który reprezentuję, nie jest:  - powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Beneficjentem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;  - będący podmiotem pozostającym z Beneficjentem lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;  - będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Beneficjenta w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;  - będący podmiotem powiązanym osobowo z Beneficjentem w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. |
| II | Oświadczam, że jednostka, którą reprezentuję, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. |

…….……………………………………………………...

(*pieczęć i podpis Wykonawcy*)